

SID

Werk: Rot am See

Artikel:

538

ML6

Erstellt:

Kracht, Enrico

Kunde:

Datum:

24.09.2015



Prozesstechnik: B: undefiniert

Materialtext	Mat. Nr.	µm	Aufbau	Prozessaufbau
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	VS	1
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	400		2
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		3
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		4
B-RS-FR4-ML-0.93mm-035+035-TG150-HF	50200663	35	L2	5
		930		
		35	L3	
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	220		6
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		7
A-RS-FR4-Prepreg-1080-TG150-HF	50200641	0		8
B-RS-FR4-ML-0.93mm-035+035-TG150-HF	50200663	35	L4	9
		930		
		35	L5	
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	400		10
A-RS-FR4-Prepreg-7628-TG150-HF	50200643	0		11
A-RS-FR4-Prepreg-2116-TG150-HF	50200642	0		12
A-RS Kupferfolie-035my 330x490mm	50200242	35	RS	13

B00:

Dicke nach Verpressen

B00:

3090 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3410 µm

Dmin:

2770 µm

Gesamtdicke über alles

0 µm

Tol+:

0 µm

Tol-:

0 µm

Dmax:

0 µm

Dmin:

0 µm

Kundenforderung

Dicke (D):

3200 µm

Tol+:

320 µm

Tol-:

320 µm

Dmax:

3520 µm

Dmin:

2880 µm

Messstelle:

(05) über LM und galv.Cu; beidseitig

nominal:

3090 µm

Version 1.2.14.14

© Würth Elektronik